

EDITORIAL

Zuverlässigkeit – Sicherstellung durch abgestimmte Technologieketten, passende Kontaktierung und gut designte, aktive Bauelemente	1129
---	------

VERBÄNDE

 FBDi - Informationen	1183
---	------

F E D - Informationen	1205
------------------------------	------

 ZVEI: - Informationen	1244
--	------

 MAPS - Mitteilungen	1275
--	------

 3-D MID - Informationen	1280
--	------

DVS - Mitteilungen	1313
---------------------------	------

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes	1132
SMT Hybrid Packaging 2014	1150
Neue Normen	1169
Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung	1170

BAUELEMENTE

Neue Lösungen für effiziente LED-Leuchtsysteme	1173
Steckverbinder optimiert für anspruchsvolle Anwendungen	1176
Optimierte Leistungsbausteine für High-End-Industrie- anwendungen	1179
DC-DC-Abwärtswandler sparen Platz auf den Leiterplatten	1182

DESIGN

Arbeitskreis Design Chain für Elektronik Komponenten	1186
Optimieren der Thermodynamik einer Leiterplatte	1197
System-on-Chip-Lösungen für leistungsfähige Low-Power-Designs	1200

DESIGN

Zuken treibt Cadstar und CR-8000 in Richtung noch höherer Produktivität und Frequenz	1202
--	------

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit): Nur als Industrieland ist Deutschland erfolgreich. Industriepolitische Fehlsteuerung der Energiewende ist nicht beendet	1216
Stillstand ist Rückschritt oder Leiterplattenhersteller müssen aktiv bleiben, um Schritt zu halten	1220
Die Leiterplatte wird multifunktional – Bericht zum 10. Kooperationsforum	1224
Firmengründerin übergibt Leiterplatten-Unternehmen an ihre Kinder	1230
13. Leiterplatten-Weltkonferenz – welche Technologien, Marktanforderungen und Trends fordert die Zukunft	1232
ECWC13 mit Verleihung des Best Paper Awards beendet	1243

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Konkurrenzfähige automatische Bestückung von THT-Bauteilen im Hochlohnland Schweiz?	1250
VacuBond – Optical Bonding der nächsten Generation	1254
EBL 2014 – Von Hochstrom bis Hochintegration	1256
Reinigungsprogramm mit Anspruch auf führende Rolle	1260
Multifunktionswerkzeuge und Crimpzange erstmals in ESD-gerechter Ausführung	1260
Volumenintegration – Stapeln, Falten, Vergraben	1261
Selektive Lötstation von IPTE	1268
Erstellungszentrum für Nadelbettadapter	1268
BMK Group – 20 Jahre Begeisterung für Elektronik	1270
Löhnt Industribedarf – neue Produkte im Portfolio	1272

ANALYTIK & TEST

Viscom feiert – 30 Jahre Inspektion und 30 Jahre Erfolg	1277
Messdatenerfassung mit Sicherheitsvorteil	1278
Echtzeit-Messungen ermöglichen schnelles Überwachen und Erfassen von Daten in Smart-Grids	1279

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit implantierter Medizinprodukte – Herausforderung für OEM	1283	Neue Themenplattform Automotive – Electronics, Infrastructure and Software	1322
Raffungsmodelle für die Qualifikation von Einpresskontakten für Leiterplatten	1288	Microelectronics Saxony – Sensoren für eine smarte Welt	1325
Zuverlässigkeitsuntersuchungen an einer hochtemperaturtauglichen SOI-CMOS-Technologie	1299	Kolumne: Sogar auf der Sonne gibt es Flecken	1333
Patente	1309	PLUS-Firmenverzeichnis	1335
		Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1359
		Stellenmarkt	1201 / 1361, 1363
		Inserentenindex	1365
		Mediadaten	1366
		Impressum	1367
Die Innovationsallianz Photovoltaik will die Zukunft der deutschen Solarindustrie sichern	1314	Produkt des Monats	1368

FORUM

Titelbild: Q-print – Das PLUS für unsere Kunden: Die Q-print electronic GmbH ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner in allen Fragen der Leiterplattenfertigung. Klein-, Mittel- oder Großserie – das im Jahre 1995 gegründete Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und gewährleistet mit überlegenen Produkten und individuellen Dienstleistungen absolute Kontinuität und Qualität. Gemeinsam mit unserem engagierten und qualifizierten Team konnten wir seit unserer Gründung ein stetiges und gesundes Wachstum verzeichnen. Nicht nur unsere Betriebsräumlichkeiten wurden vergrößert, auch unser Angebotsspektrum wurde im Laufe der Jahre maßgeblich weiterentwickelt, um dem Anspruch und Bedürfnis unserer Kunden zu jedem Zeitpunkt gerecht zu werden. Denn das ist unser höchstes Ziel. Geschultes Personal, Einrichtungen auf dem neuesten Stand der Technik sowie ein nach DIN ISO 9001/2008 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem stehen für dauerhafte Präzision.

www.Q-print.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e.V.
Tel. +49 (0) 8563 9788908
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49/30/8349059
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e.V.
Tel. +49/3677/69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49/91 1/5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49/211/1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.